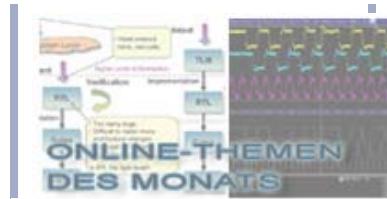




[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Sitemap](#) [EL-info Newsletter](#) [Webcode](#) [Jobs](#) [RSS](#) [Home](#)



Volltext-Suche



Webcode

ok

Geben Sie hier den 6-stelligen Webcode aus der Zeitschrift ein.

[Neue Produkte/Nachrichten](#)
[Kontakt](#)

[Aktuelle Ausgabe](#)

[Leser-Lounge](#)

[Magazin](#)

[Veranstaltungen](#)

[Verlag](#)

Produkte

- [Baulemente](#)
- [Boards und Systeme](#)
- [Mess- und Testgeräte](#)
- [Stromversorgungen](#)
- [Gehäuse](#)
- [Entwicklungstools](#)
- [Software](#)
- [Automatisierung](#)
- [Fertigungstechnik u. Zubehör](#)

Nachrichten

- [Namen und Nachrichten](#)
- [News from USA and Asia](#)

Aktuelles Heft



[Download im PDF-Format](#)

Themen Dezember 2009:

SPEZIAL:

Intelligente Entwicklung:
COMPUTERS-ON-MODULE
steuern Lasermaschinen

LOGIKBAUSTEINE:

Neue FPGA-Generation mit
integrierten Transceivern
senkt die Systemkosten

MIKROCONTROLLER:

Compilerunabhängiger Code
verringert das Designrisiko
und bedeutet effizientere

Code auf einer größeren Zahl von
Embedded-Geräten einsetzen



Leser-Lounge



WHITEPAPER

Analog MUX

Mit "iCapture Analog MUX" stellt Tektronix eine Möglichkeit vor, elektrische Signale digital und analog zu analysieren mit nur einer Spannungssonde. Das Whitepaper erklärt die Technologie und ihren Nutzen für Elektronik-Entwickler.



[Lesen Sie mehr](#)

Namen und Nachrichten

Gleichzeitige Entwicklung von Chip, Gehäuse und Board bei System-in-Package-Anwendungen



15.12.2009 __ **Forschungsprojekt CoSiP unter der Leitung von Infineon**
Durch die zunehmende Komplexität von Mikroelektroniksystemen wird es bei System-in-Package-Anwendungen immer wichtiger, die Entwicklung von Chips, Chipgehäuse und Board miteinander zu verknüpfen und aufeinander abzustimmen.

Zur Entwicklung einer derartigen durchgängigen Entwurfsumgebung für System-in-Package-Lösungen wurde unter der Leitung von **Infineon** das Projekt „CoSiP“ ins Leben gerufen. An dem vom BMBF geförderten Projekt sind des Weiteren das Fraunhofer IZM, der Geschäftsbereich Automotive Electronics von Bosch, der Sektor Healthcare von Siemens und Amic Angewandte Micro-Messtechnik beteiligt.

Im Rahmen von CoSiP sollen neue Methoden erarbeitet werden, um die Komponenten eines System-in-Package zukünftig gemeinsam mit dem Board und auf dieses abgestimmt zu entwerfen. Hierzu wollen die Projektpartner auch die Grundlagen der für die Entwicklung nötigen Designtools schaffen. Ziel ist es außerdem, die Entwicklungszeit für künftige System-in-Package-Designs um mindestens ein Drittel zu verkürzen. (ih)

Weitere Infos: [Infineon](#)

[zurück](#)



[Weitere Artikel mit dem Begriff "Infineon"](#)

Eine Publikation der **AT-Fachverlag GmbH**

Newsletter

Möchten Sie die Elektronik
News wöchentlich per eMail
erhalten?
Dann klicken Sie bitte [hier](#).

RSS



Hier können Sie unsere
RSS-Feeds mit den neuesten
Nachrichten aus der Welt der
Elektronik abonnieren:

[->Aktuelle Nachrichten](#)

[->News from USA and Asia](#)